

国投证券股份有限公司
关于北京金橙子科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，就金橙子 2025 年度（以下简称“本持续督导期”）持续督导跟踪情况报告如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与金橙子签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期问访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解金橙子业务情况，对金橙子开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后予以披露。	金橙子在本持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起 5 个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	金橙子在本持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况。
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履	在本持续督导期间，保荐机构督导金橙子及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所

	行其所作出的各项承诺。	所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促金橙子依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促金橙子依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后5个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，保荐机构对金橙子的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，金橙子及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，金橙子及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，金橙子未发生左述情况。

14	发现以下情形之一的,督促上市公司作出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间,金橙子未发生左述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求。
16	上市公司出现以下情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场检查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用;(三)可能存在重大违规担保;(四)控股股东、实际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(五)资金往来或者现金流存在重大异常;(六)上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间,金橙子未发生左述情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

本持续督导期间,保荐机构和保荐代表人未发现金橙子存在需要进行整改的重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间,公司未发生重大风险事项。公司目前面临的主要风险因素如下:

(一) 核心竞争力风险

1、核心技术泄密及核心技术人员流失风险

随着市场及公司发展,存在因核心技术人员流失或者工作失误等偶发因素导致核心技术泄露的风险,会对公司竞争优势及生产经营产生不利影响。

若公司未来不能建立完备的激励机制、人才培养机制，无法有效吸引和保留关键核心技术人员和研发团队，将面临关键核心技术人员流失或高端人才不足，进而在技术研发突破和创新方面落后于竞争对手的风险，将对公司长期经营发展造成不利影响。

2、研发创新能力无法持续满足激光先进制造领域发展的风险

若公司研发团队的研发创新能力无法有效满足公司相关技术及产品的研发需求，或无法满足下游激光先进制造的发展需求，均可能对公司的市场竞争能力及经营业绩造成不利影响。

公司将持续增强市场信息搜集能力，提升研发人员素质，不断吸纳高端人才，以提升公司的研发创新能力。

3、与国际厂商在高端应用领域存在差距的风险

相比德国 Scaps、德国 Scanlab 等国际厂商，公司在中高端振镜产品一些性能指标、机器人和 3D 振镜联动加工技术、实时光束波动偏移补偿技术、激光熔覆等细节及技术方面尚存在一定差距；目前公司在高端应用领域的控制系统、振镜产品销售数量占比仍处于较低水平。故公司可能面临在高端应用技术方面无法赶超国外竞争对手，或在高端应用领域无法实现有效市场开拓的风险。

（二）经营风险

1、新产品市场开拓风险

公司根据市场需求持续进行控制系统的研发及更新，同时推出高精密振镜、3D 打印控制系统、焊接控制系统、消费级控制卡等产品。受到整体经济环境、市场需求变化、产品性能等多重因素影响，部分产品的客户验证、推广进度较为缓慢。公司新产品的开拓和发展需要一定的市场验证周期及客户积累，若在产品开发及客户开拓等方面不能取得预期进展，则面临新产品无法有效开拓市场的风险。

2、产品持续受盗版侵权的风险

公司激光加工控制系统核心是工业软件，近些年行业内存在较严重的盗版行

为。打击盗版成本较高、难度较大，近几年盗版市场未受到有力约束。若未来无法通过增强加密方式及法律手段遏制盗版行为，公司将面临激光振镜控制产品持续被盗版、合法权益持续被侵害的风险，甚至长期经营发展受到不利影响。

公司将持续对产品加密方式进行增强及升级，以避免新产品被破解和盗版的可能；同时采取相应的法律手段，遏制和打击盗版产品的发展势头。

3、经营业绩波动的风险

公司未来盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、管理层经营决策等多方面因素影响。随着公司经营规模扩大，对公司在运营管理、内部控制、财务管理等方面提出更高的要求。

如果公司的内部管理流程和人员结构的调整未能及时满足规模扩大的要求，可能存在因规模扩张导致的管理和内控风险，对公司未来的持续盈利能力造成不利影响。公司将及时调整、建立适合业务发展的内部管理流程和内控体系，严格执行内控与预算管理，做好公司整体战略计划的贯彻落实。

（三）财务风险

1、存货跌价风险

激光控制产品技术更新迭代速度较快，若未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，将增加计提存货跌价准备金额，从而对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。

2、税务优惠风险

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司销售自主开发的激光控制软件产品享受上述增值税即征即退优惠政策。若相关政策发生变化或者公司不能持续符合相应税收优惠条件，将对公司利润水平造成不利影响。

3、商誉减值风险

截至 2025 年 12 月 31 日，公司商誉的账面价值为 9,214,929.84 元，为公司收购武汉奇造科技有限公司（以下简称“武汉奇造”）100%的股权之成本超过其可辨认净资产公允价值份额的金额。未来，若因经济环境波动、市场需求变化、武汉奇造经营管理出现重大失误等因素，导致其经营业绩不达预期，则上述收购形成的商誉存在相应的减值风险，从而可能对公司的经营业绩产生不良影响。

4、子公司亏损或净资产为负的风险

截至报告期末，公司控股孙公司苏州市捷恩泰科技有限公司（以下简称“苏州捷恩泰”）因累计未弥补亏损金额已超过股东投入的实收资本及其他权益项目合计，导致净资产为负数。若苏州捷恩泰未来经营持续无法达到预期，可能会对公司整体盈利能力和持续经营能力产生不利影响。

（四）行业风险

公司产品为激光加工控制系统、激光系统集成硬件及激光精密加工设备，均应用于工业激光加工应用领域，与激光加工行业的整体发展密切相关。公司存在因国家政策调整或宏观经济出现周期性波动等因素导致激光加工制造领域市场发展不达预期，而使公司业务增长速度放缓，甚至业绩下降的风险。

（五）宏观环境风险

全球范围内各种冲突、博弈不断。部分地区局势陷入紧张，贸易冲突时有发生，全球地缘政治格局正在不断发生变化，也加剧了全球市场的不稳定。这些不确定性风险可能会对公司的海外市场带来一定影响。

公司产品的部分核心芯片目前主要来源于进口，若受到国际环境影响，芯片供给无法满足公司生产所需或成本上升，可能会对公司经营及业绩造成不利影响。公司已采用核心芯片海外多品牌采购路线，并同时预研了国产替代芯片并行的方案，以避免上述风险。

（六）其他重大风险

1、募投项目实施风险

公司募投项目的可行性研究系基于当时产业政策、市场环境等因素作出。在

公司募投项目实施的过程中，可能面临行业竞争加剧、市场环境变化、生产研发过程中关键技术未能突破、市场推广不利、相关人员规范意识及重视程度不足等诸多不确定因素，可能对公司募投项目的规范实施效果产生不利影响，存在募投项目规范运作的预期效益难以实现的风险。

2、并购事项相关风险

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司 55% 股权并募集配套资金，该事项已经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过，相关事项仍在有序推进过程中，存在多项风险，包括但不限于审批风险、本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险、可能摊薄上市公司即期回报的风险、商誉减值的风险、方案调整的风险等。

3、出售参股公司股权相关风险

公司出售参股公司苏州卡门哈斯激光技术有限责任公司（以下简称“卡门哈斯”）股权事项涉及交易对手方较多，股权转让价款支付周期较长，且交易对手方在支付首笔股权转让价款已出现逾期付款事实，未来仍存在交易对手方不能按协议约定支付股权转让价款的履约风险。

4、与专业机构合作投资相关风险

公司与专业机构合作投资相关事项尚需合伙企业办理工商变更登记及中国证券投资基金业协会相关备案手续，后续投资进展及完成情况尚存在不确定性。拟投资合伙企业在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险。

四、重大违规事项

本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025 年度	2024 年度	本报告期比上年同期增减
营业收入	25,339.82	21,212.38	19.46%
利润总额	3,714.18	2,473.10	50.18%
归属于上市公司股东的净利润	3,687.71	3,049.50	20.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	3,010.14	2,031.15	48.20%
经营活动产生的现金流量净额	2,806.73	2,152.28	30.41%
主要会计数据	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	95,661.45	92,487.66	3.43%
总资产	104,087.70	98,215.23	5.98%

2025 年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2025 年	2024 年	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元 / 股）	0.37	0.30	23.33%
稀释每股收益（元 / 股）	0.36	0.30	20.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.30	0.20	50.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.92	3.30	增加 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.20	2.20	增加 1.00 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	24.02	28.55	减少 4.53 个百分点

2025 年度，公司上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、利润总额同比增长 50.18%，主要系报告期内公司持续深耕市场、拓展销售渠道，激光加工控制系统、激光系统集成硬件、激光精密加工设备三大核心业务均实现平稳增长；同时深化内部管理，本年度顺利实施员工持股计划，虽相应增加股份支付相关费用，但通过优化管理，期间费用仍实现有效管控。此外，联营企业经营状况良好，业绩稳步提升，直接带动公司投资收益的同比增长，多因素推动利润总额有所增长。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 48.20%，主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润增长，同时本年度闲置资金现金管理规模较上期缩减，叠加市场利率走低等多重因素，综合导致非经常性损益有所减少所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增长 30.41%，主要系报告期内公司持续加强供应商管理体系，更多采用承兑汇票，导致购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

4、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 50.00%，主要系报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）自主、安全、可控的核心技术

公司高度重视研发技术的自主性和创新性，持续加大研发投入，拥有多项激光控制核心技术发明专利。产品能够适用于激光加工制造领域复杂多变的加工环境，紧跟行业在高速率、高精度、柔性化等发展趋势，不断进行技术创新，推动公司核心技术持续向前快速发展，促使公司技术优势持续保持领先水平。

（二）领先的行业地位

通过长期的技术积累和市场拓展，公司的振镜控制系统产品在关键性能指标上已经具备明显优势。凭借卓越的产品性能和优质的服务，公司产品已经覆盖了激光行业的众多知名企业，得到了广大客户的认可和好评。公司在国内细分领域占据了较高的市场份额，品牌影响力也在行业内不断提升。在海外市场，公司相关产品以高性价比受到广泛欢迎，客户认可度也越来越高。

（三）完善的产业链布局

公司积极与高等院校、产业链相关企业开展技术、产品、股权等多方位合作，参股了多家行业内优质企业，与产业战略投资者保持良好的合作关系。公司构建了完整的技术平台，结合自身的技术优势，与产业链企业深度融合、精准协同，联合呈现最佳解决方案，助力激光生态协同发展，为激光智造产业升级注入新动

能。

（四）多元化的核心产品

公司以激光振镜加工控制系统为核心，围绕“光束传输与控制”不断拓展产品线，开发了激光伺服加工控制系统产品、光机电系统集成硬件及集成加工解决方案，如自研光栅振镜电机、数字振镜产品、高功率焊接振镜、调高器等产品。公司也可提供高端定制激光加工装备，如激光调阻设备、激光晶圆修调等高精密激光装备。聚焦智能化、柔性化，公司推出了适配多场景的开放式控制平台，赋能行业智能化升级。公司多元化的产品策略，满足了不同客户在不同领域的应用需求。

（五）全方位的解决方案

公司可依据客户具体应用需求，依托丰富的激光加工行业实践经验，为客户提供全方位的激光加工应用集成解决方案，如电池极片划线、电池极片清洗、电池壳体毛化、涂布轧辊清洗、手机和手表中框清洗、三维五轴联动切割和破阳、碳化硅激光刻蚀、钙钛矿激光划线等集成加工解决方案产品，满足客户在激光加工制造过程中的各种需求。

（六）优质高效的客户服务

公司在北京、苏州、东莞、鞍山、武汉等国内激光产业聚集的地区设置有子公司、分公司，在济南设置有工艺中心。同时，公司组建了交付与服务部，确保为客户提供优质高效的技术支持和售后服务。此外，公司在美国、欧洲等海外市场将逐步完善本地化团队与服务体系，提升海外客户服务响应速度。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2025 年度，公司研发费用为 6,085.99 万元，同比增长 0.49%，增速放缓，主要系公司持续强化内部管理，研发费用得到有效控制所致。

(二) 研发进展

2025 年度，公司持续对各产品进行技术研发和攻关，形成了多项新的技术及功能，同时对已有的技术也持续进行更新迭代。2025 年度，公司新增授权发明专利 14 项，实用新型专利 12 项，外观专利 5 项，软件著作权 21 项，商标 2 项。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 108 项专利获得授权（其中发明专利 56 项，实用新型专利 46 项，外观设计专利 6 项），著作权 163 项，商标 97 项。

2025 年度，公司在研项目进展情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	激光调阻系统	438.82	249.51	941.60	1、晶圆级激光调阻机研发项目已经结项。 2、多圈线绕电位器综合测试仪项目已经结项。 3、高阻测量设备正在系统可靠性测试。 4、中阻扩展量程设备正在联合调试。	1、实现高阻 1K—1G 全量程自动测量精度优于 1%。 2、实现电阻范围 100mΩ-10Ω，测量精度±[0.05%+0.5%/R(Ω)]；电阻范围 1MΩ-10MΩ，测量精度±[0.05%+0.05%×R(MΩ)]。	技术国内领先、工艺考究、整套系统稳定可靠。	激光精密调阻
2	柔性制造平台	812.56	1,048.47	4,129.51	1、锂电领域持续深耕，方壳电池、圆柱电池各生产环节设备保持批量出货，市场份额稳步提升，客户覆盖头部动力电池厂商。 2、汽车领域加速突破，覆盖电驱系统，电控系统等环节应用，行业认可度进一步提升。	焊接方向： 融合闭环反馈、振镜视觉与机器人技术，加快飞行焊接产品落地。 深化汽车四门两盖及锂电汇流排焊接场景应用。 巩固锂电优势地位，扩大汽车电驱电控市场份额。	国内领先，涉及多轴运动轨迹规划、机器人运动学、计算机图形学、激光焊接工艺、闭环反馈控制、高速振镜视觉等技术。	动力电池、储能电池，汽车三电系统等领域焊接
					3、三维五轴方向已实现某公司异形曲面零件的精密切割功能，加工精度能满足业务要求。后续，进一步研究工艺参数，提升加工节拍。	三维五轴方向： 提供面向异形曲面类零件精密切割及纹理填充加工需求，提供可靠的整体解决方案（CAM 软件，控制		在高端消费电子领域（VR、手表、手机、

					本项目所开发的三维五轴精密微加工解决方案，已应用于另一个应用场景，并形成销售合同。	系统、振镜系统)。		无人机等产品的曲面零部件加工)，有较好的应用前景
3	高精度数字振镜	780.10	751.71	2,743.97	<p>1、在数字振镜驱动器方面完成了驱动器的技术升级迭代，采用了高效的PWM 功率驱动和先进的状态空间控制算法，具备高精度、高可靠性和低静态功耗的特点，进一步降低了振镜的温漂。</p> <p>2、采用 G15 数字电机完成了 FS20 振镜的小尺寸优化设计。</p> <p>3、五轴振镜方面： 1) 开发装配流程及配套工装。 2) 校正理论已完成并应用于校正流程。 3) 开发校正流程，应用于上位机校正模块。 4) 开发上位机校正模块，用于引导用户进行校正。 5) 开发上位机实现五轴振镜圆孔、矩形孔加工功能。</p>	<p>1、针对 3D 打印应用，实现小尺寸和高可靠性设计，满足多头拼接应用。</p> <p>2、五轴振镜方面：完成最小直径 100 μm，深径比 10: 1 且锥度<0.1° 的垂壁孔工艺开发。</p>	<p>1、国内领先水平，涉及高精度光栅码盘信号解算、数字振镜电机仿真设计、先进运动控制算法、高效的功率驱动等技术。</p> <p>2、五轴振镜方面：技术国内领先、整套系统稳定可靠。</p>	FS20: 3D 打印、3C 五轴振镜：航空领域无锥度圆柱孔
4	激光伺服控制系统	300.00	272.26	1,523.13	<p>本项目报告期内已经结项。</p>	<p>1、完成裁床双头加工控制系统的 V1.0 版本现场验证及交付。</p> <p>2、完成高速机控制系统的现场验证及交付，运行速度 120m/min，运行加速度 2G。</p> <p>3、完成总线随控一体激光切割系统的现</p>	<p>国内领先水平，涉及 CAD/CAM、高速多轴运动控制算法、高速多头控制算法，高速随控一体算法。</p>	裁床及激光切割领域

						场验证。		
5	转镜控制系统	420.00	25.98	1,189.49	本项目报告期内已经结项。	实现棱镜扫描模块国产化。	技术领先，激光线扫描速度达 300m/s，并且具有稳定可靠的系统集成方案，可满足高速激光加工应用。	超高速激光加工
6	飞动控制系统	250.00	51.91	1,108.97	本项目报告期内已经结项。	产品批量稳定交付	技术领先，打码速度相比传统工艺提升 2-3 倍。	高速线缆、自动化、流水线产线等领域
7	无限视野联动-智能控制系统	525.00	185.26	624.33	1、完成反向间隙重要功能升级。 2、简化参数设定，增加加工参数的通用性。 3、优化升级闭环控制，联动加工同步性得到改善。 4、销售量较上一年度提高 50%。	输出行业专用软件，逐步提高占有率。	行业领先，涉及高精度振镜、伺服平台控制、嵌入式软、硬件技术、计算机图形学、激光加工工艺等多个领域。	应用于玻璃打砂、除膜、大幅面不锈钢标刻等领域。
8	激光 3D 打印系统	380.00	75.16	1,414.47	本项目报告期内已经结项。	完成重点客户实现设备交付。	行业领先，涉及高精度振镜控制、伺服平台控制、嵌入式软、硬件技术、计算机图形学、激光 3D 打印加工工艺等多个领域。	激光 3D 打印 SLA、SLM、SLS 领域
9	切打一体项目	296.49	236.95	236.95	1、完成切打一体控制板的软硬件开发和测试。 2、完成切打一体控制卡的小批量生产。 3、增加联动反向间隙功能和轴夹角功能。 4、简化参数设定，增加加工参数的通用性；优化升级闭环控制，联动加工同步性得到改善。 5、增加准直功能。 6、进入客户试用阶段。	完成切打一体产品的批量转产。	行业领先，涉及高精度振镜、伺服平台控制、嵌入式软、硬件技术、计算机图形学、激光加工工艺等多个领域。	覆盖膜切割、服装、鞋类
10	M30 一体机项目	154.64	195.74	195.74	1、完成 M30 一体机的软硬件开发。 2、进入到产品样机的测试阶段。	1、实现稳定的单屏多卡切换功能。 2、实现高性能 QCW 焊接功能。 3、实现高性能多轴	行业领先，涉及高精度振镜运动控制、嵌入式软、硬件技术、计算机图形学、激光加工工艺等多个领域。	广泛应用于中高端激光加工领域，

						运动控制功能。		如新能源、光伏等
11	脉冲调阻设备研发项目	189.40	145.65	145.65	1、完成原始样机的开发和测试。 2、正在根据客户的反馈进行性能优化。	1、实现 192 通道高速稳定修调和测量。 2、实现测量精度±1Ω，重复测量精度达到 0.03%。	技术国内领先、工艺考究、整套系统稳定可靠。	高精度和高速电压调阻
12	消费级产品	499.59	368.55	368.55	1、完成消费级控制卡和嵌入式服务程序产品样机的开发。 2、正在根据客户的反馈需求进行功能和性能优化。	1、实现消费级激光雕刻机的内雕、彩绘、各配件状态闭环、边转边打、多激光器控制、多场镜校正表等复杂功能。 2、实现硬件层面实时监测安全相关输入输出和瞬时关光处理。	行业领先，涉及高精度振镜运动控制、嵌入式软、硬件技术、计算机图形学、激光加工工艺等多个领域。	消费级用户，C 端个体、家庭用户，工作室等场景激光雕刻和切割
13	轴控通用机床系统项目	300.00	187.18	187.18	本项目为报告期内新增立项。	1、完成裁床控制系统拐角控制，裁切工艺，双头避障，投影仪、视觉等功能需求。 2、完成 OCC 管切割三维引擎重构。 3、完成激光高速机加减速算法重构。 4、完成自研调高算法在 Zmotion 板卡上的稳定性测试。	国内领先水平，涉及 CAD/CAM、高速多轴运动控制算法、高速多头控制算法，高速随控一体算法，管切割算法等	裁床及激光切割领域
14	金属 3D 打印项目	300.00	35.72	35.72	软件深度优化，全局参数拆分，底层算法深度优化，增加 Job 文件解析，增加 RTC 卡适配功能，优化智能跳层扫描、智能合并填充功能，优化多零件多工艺包功能；修改表皮轮廓和小轮廓单独识别算法；优化多振镜拼接零件面积分配问题；优化多振镜逆风扫描算法，开发多振镜拼接自动视觉识别校正方案等。	完成重点客户实现软件交付	行业领先，涉及高精度振镜控制、伺服平台控制、嵌入式软、硬件技术、计算机图形学、激光 3D 打印加工工艺等多个领域。	激光 3D 打印 SLM 领域
15	转镜	94.88	90.93	90.93	1、进行转镜反射镜制造	已实现转镜反射镜制	技术国内领先；反射镜	激光清

	反射镜制造技术攻关项目				技术攻关。 2、完成转镜扫描头结构设计。 3、进行转镜扫描系统软件设计。	造工艺路线成熟可控，转镜反射镜各项指标参数均达到国际领先水平。	制造工艺技术趋于成熟；样机可大幅提升激光加工效率。	洗、激光划线、激光雕刻、3D打印
16	清洗设备控制系统项目	281.28	36.12	36.12	1、完成清洗控制卡的软件开发。 2、进入到产品样机的测试阶段。	1、兼容市面脉冲和连续激光清洗的控制，并开发出正选、莉萨如、8字等多种扫描方式，以更好的达到清洗效果。	行业领先，尤其是低功率脉冲清洗设备，通过开发手持屏的方案解决调参难的问题。	可用于造船、轨道等金属表面的油污、锈迹、除漆。
	合计	6,022.76	3,957.09	14,972.29	-	-	-	-

注：1、“激光伺服控制系统”“转镜控制系统”“飞动控制系统”“激光 3D 打印系统”项目已于报告期内完成结项；

2、“激光调阻系统”“无限视野联动-智能控制系统”项目部分子项目已于报告期内完成结项，报告期内新增立项子项目；“柔性制造平台”“高精度数字振镜”项目报告期内新增立项子项目；

3、“切打一体项目”“M30 一体机项目”“电压调阻测量箱”“消费级产品”“轴控通用机床系统项目”“金属 3D 打印项目”“转镜反射镜制造技术攻关项目”“清洗设备控制系统项目”为报告期内新增立项的项目；

4、上表“预计总投资规模”及“累计投入金额”不含 2025 年前已结项的子项目相关数据。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1971 号文），公司于 2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元，应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资

金净额为 606,213,138.68 元。该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	68,709.76
其中：超募资金金额	21,029.52
减：直接支付发行费用	8,088.44
二、募集资金净额	60,621.31
减：	
以前年度已使用金额	33,514.67
本年度使用金额	12,776.23
其他-永久补充流动资金	7,222.37
其他-节余资金管理	0.14
加：	
募集资金利息收入	703.45
募集资金理财收益	1,668.84
三、报告期期末募集资金余额	9,480.19

2025 年度，金橙子募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，金橙子对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的股份不存在质押、冻结及减持的情况。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

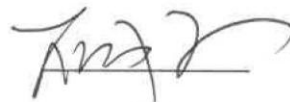
(以下无正文)

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：



孙 健



万能鑫



国投证券股份有限公司

2026年4月8日